大気圧熱プラズマジェット照射による溶融シリコン内温度分布の可視化

Visualization of Temperature Distribution in Molten Silicon

by Atmospheric Pressure Thermal Plasma Jet

広大院先端研¹ ^O水川 友里¹, 花房 宏明¹, 東 清一郎¹

Hiroshima Univ.¹, °Yuri Mizukawa¹, Hiroaki Hanafusa¹, Seiichiro Higashi¹

E-mail: y-mizukawa@hiroshima-u.ac.jp

序>高結晶性シリコン薄膜を得るため,結晶化現象の解明に 関して様々な研究が成されてきた[1,2].しかし,溶融シリコ ンの温度分布と結晶成長過程とを同時に得ることは実現して いない.そこでレーザーによる非接触温度測定[3]と高速度カ メラによる実時間観察を組み合わせ,大気圧熱プラズマジェ ット(Thermal Plasma Jet: TPJ)照射時の溶融シリコンにおける 実時間映像・温度分布情報を同時に得る試みを行った.

実験>温度測定用の石英基板(厚さ:525 µm)と,その上に a-Si 膜を 100 nm 堆積した観察用サンプルの2枚を使用した. リニア型ステージは,走査速度 v:0.3~1.0 m/sとし,基板間距 離 d:2.0~8.0 mm とした.TPJ 発生条件は,Ar 流量:約 2.0~3.0 L/min,投入電力 P:約 1.5~1.8 kW とした(Fig.1).高速度カ メラの設定は,露光時間:1~3 µs, FPS: 3000 とし,非接触 温度測定ではレーザー波長 632.8 nm とした.

結果>得られた実時間カメラ画像から,溶融シリコンは縦: 約940 µm,横:約410 µmの楕円型であることが判明した. これより非接触温度測定とカメラ画像にて得られたデータ が矛盾なく一致するためには、ジェットの形状は非等方ガウ シアン分布であり、半値幅:400 µm,500 µm,伝達効率:95%, 85%の2つのガウシアンであることが分かった.Fig.2 (a)は 実測値(赤線)と理論値(青線)における反射率を表し、こ れらのフィッティングにより温度解析した.Fig.2 (b)は、TPJ 照射時の基板温度の時間経過であり、このグラフから6 ms で最大基板表面温度が約1786 K であることが明らかとなっ た.温度測定結果をカメラ画像に重ね合わせる事により得た 溶融シリコン内温度分布をFig.2 (c)に示す.溶融・結晶化領 域境界付近の,融点よりも温度が低い過冷却領域の温度分布 が約20 K 程度で最大長さ約50 µm であることが、今回の溶 融シリコン内温度分布解析で初めて明らかとなった.また基



Fig. 1. Schematic diagram of experimental setup for a-Si crystallization during TPJ irradiation with high-speed camera and non-contact temperature measurement apparatus.



Fig. 2. Diagrams of (a) reflectivity (red line: experiment data, blue line: simulation data), (b) temperature of the substrate surface and (c) the image combined with a high-speed camera image and an isothermal diagram for *in-situ* measurement of a-Si film crystallization.

板走査方向に対して垂直方向の温度勾配は約 8.93×10⁴ K/cm であり,結晶成長し始めた結晶粒は垂直 方向の温度勾配に沿って成長していることが明らかとなった.

参考文献>[1] GJ. Galvin, et. al., Phys. Rev. B 27 (1983) 1079. [2] S. Hayashi, et. al., Appl. Phys. Express 3 (2010) 061401. [3] T. Okada, et. al., Jpn. J. Appl. Phys., 45 (2006) 4355.